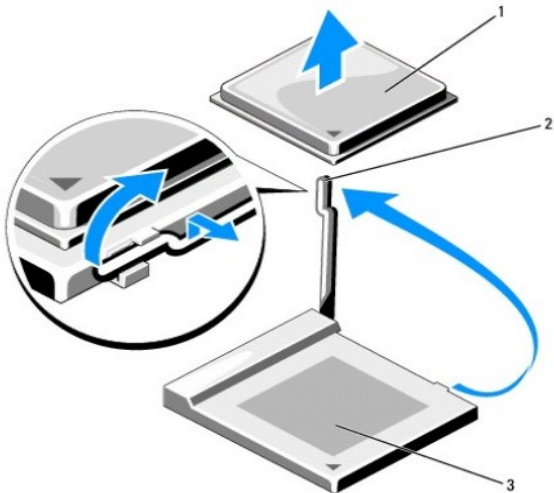


TALLER MME – PRÁCTICA 10 – DELL OptiPlex 740

NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓN	Apellidos, Nome
<div></div>	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	
Material necesario		Práctica: Desmontar disipador e CPU. Identificar CPU. Aplicar pasta térmica.
<ul style="list-style-type: none"><li>■ <a href="#">PC Dell PowerEdge 740</a></li><li>■ Alfombra condutora</li><li>■ Panel lateral caixa ATX/BTX</li><li>■ [1] <a href="#">Sistemas Dell OptiPlex 740 Guía del usuario</a></li><li>■ [2] <a href="#">OptiPlex 740 Guia de referencia rápida</a></li><li>■ Papel limpeza</li><li>■ Pasta térmica</li><li>■ [3] <a href="#">Identificar procesador Intel</a></li><li>■ [4] <a href="#">Identificar xeración procesador Intel</a></li><li>■ [5] <a href="#">Identificar procesador AMD</a></li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Descargarse da electricidade estática.</li><li>(2) Estender e “conectarse” a alfombra condutora.</li><li>(3) Colocar semitorre na alfombra condutora.</li><li>(4) Desmontar disipador e CPU.</li><li>(5) Limpar restos de pasta térmica.</li><li>(6) Aplicar pasta térmica na base do disipador.</li><li>(7) Montar CPU e disipador.</li></ul>

Procedemento:

- (1) Apagar e desconectar o equipo da corrente eléctrica.
- (2) Desconectar o equipo: minitorre, pantalla, teclado e rato.
- (3) Descargarse da electricidade estática tocando coas mans algo metálico desconectado e desenchufado da corrente eléctrica. Así, tocar coas mans unha chapa metálica: panel lateral dunha caixa ATX/BTX de ordenador.
- (4) Estender a alfombra condutora na mesa.
- (5) Conectar a pinza da alfombra condutora á chapa metálica.
- (6) No outro extremo da pinza temos unha pulseira antiestática, a cal poñemos.
- (7) Coller a minitorre e situala enriba da alfombra antiestática.
- (8) Desconectar a fonte de alimentación.
- (9) Desmontar disipador (páxina 116 de [1]).
- (10) Sacar CPU (páxina 117 de [1])



(11) Identificar CPU[3][4][5] e Socket:

Modelo CPU:\_\_\_\_\_ Velocidade reloxo:\_\_\_\_\_ N° núcleos:\_\_\_ N° fíos:\_\_\_

☐ Caché L1 e tamaño:

☐ Caché L2 e tamaño:

☐ Caché L3 e tamaño:

Tecnoloxías:

☐ MMX

☐ SSE

☐ SSE2

☐ SSE3

☐ SSE4

☐ Extended 3DNow!

☐ AMD64

☐ Nxbit

☐ AMD-V

☐ Protección Avanzada contra Virus

☐ Cool'n'Quiet

☐ HyperTransport

Hz HyperTransport:

Modelo Socket: \_\_\_\_\_

TDP(Thermal Design Power):\_\_\_\_\_ Consumo Enerxía(W):\_\_\_\_\_ Tecnoloxía creación(nm):\_\_\_\_\_

Outras características/tecnoloxías:

(12) Limpar restos de pasta térmica.

(13) Aplicar pasta térmica na base do disipador.

(14) Montar CPU (páxina 118 de [1]) e disipador (páxina 118 de [1]).

(15) Conectar fonte de alimentación.